



www.waferhandling.solutions

Positionstoleranz / tolerances of location		Kanten mit unbestimmter Form nach DIN ISO 13715		Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 Längen und Winkelmaß m Form und Lage K Allg.-Tol. Schweißkonst. nach DIN ISO 2768 Längen und Winkelmaß B Form und Lage F		Prüfmaße nach DIN 406-T1 Tolerierungsgrundsatz nach ISO 8015 Bewertungsgruppe für Unregelmäßigkeiten (Schweißverbindung) DIN EN ISO 5817 c	
⊕ Bohrungen / holes	0,1 mm	+0,3 +0,1 -0,3 -0,1		Maßstab: 1:5		Masse: -	
⊕ Gewinde / threads	0,1 mm	Oberflächenbeschaffenheit nach DIN EN ISO 1302 Vakuum-Dichtflächen keine Rillen und Riefen quer zum Dichtungsverlauf zulässig		Halbzeug:		Material/Oberfläche:	
⊕ Passungen / fits	0,01 mm	Dichtfläche Rz 6,3		Benennung		WAM D300	
projection ISO 128 - method 1		Datum Name		Benennung		Wafer Alignment Module	
		Gezeichnet: 18.08.2018 BC		Zeichnungsnr.:		188-423100-00	
		Freigabe:		Revision		1 / 1	
				Ersatz für:		Ersatz durch:	
		Status Änderungen Datum Name		188-423100-88.idw		A3	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patentierung oder deponierter Erfindung vorbehalten.

Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.